

(19)世界知的所有権機関
国際事務局(43)国際公開日
2005年6月16日 (16.06.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/055258 A1(51)国際特許分類⁷:

H01G 9/00, 9/012

(72)発明者; および

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/013635

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 田中 栄作
(TANAKA, Eisaku) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 ローム株式会社内 Kyoto (JP).

(22)国際出願日:

2004年9月17日 (17.09.2004)

(25)国際出願の言語:

日本語

(74)代理人: 石井 晓夫, 外 (ISHII, Akeo et al.); 〒5300041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北1番21号八千代ビル東館 Osaka (JP).

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2003-401994 2003年12月1日 (01.12.2003) JP

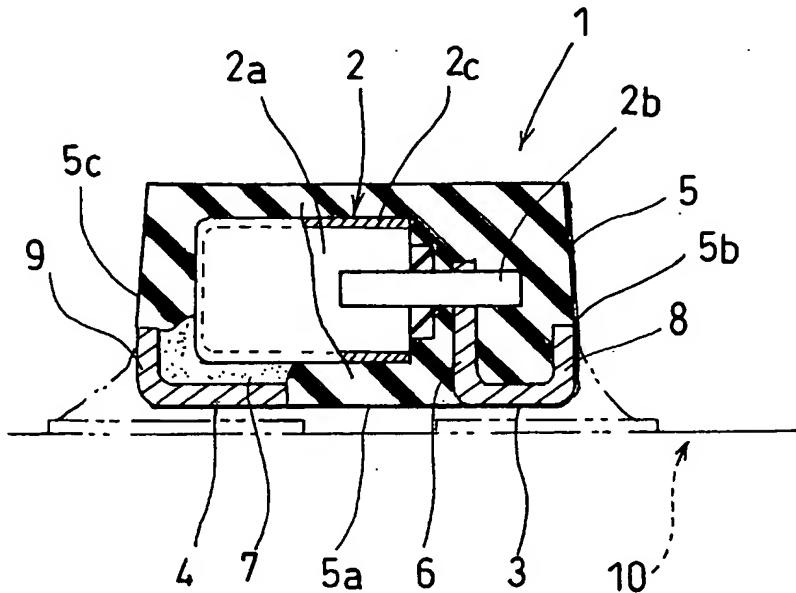
(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): ローム株式会社 (ROHM CO.,LTD) [JP/JP]; 〒6158585 京都府京都市右京区西院溝崎町21番地 Kyoto (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

/続葉有/

(54) Title: SURFACE-MOUNT SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR AND PROCESS FOR MANUFACTURING SAME

(54)発明の名称: 面実装型固体電解コンデンサ及びその製造方法



(57) Abstract: A solid electrolytic capacitor comprising a capacitor element (2), an anode lead terminal (3) electrically connected with the anode of the capacitor element, a cathode lead terminal (4) electrically connected with the cathode of the capacitor element, and a synthetic resin package body (5) for hermetically sealing the capacitor element entirely, wherein both lead terminals are buried in the bottom part (5a) of the package body such that the lower surfaces of both lead terminals are exposed in the bottom face of the package body. Raised pieces (8, 9) are provided in the portions of the anode lead terminal and the cathode lead terminal corresponding to the side faces (5b, 5c) of the package body. The raised pieces are buried in the package body such that the outer surfaces of the raised pieces are exposed in the side face of the package body, thereby enhancing soldering strength and facilitating visual judgment of acceptability of soldering.

(57)要約: コンデンサ素子2と、このコンデンサ素子における陽極に電気的に繋がる陽極リード端子3と、前記コンデンサ素子における陰極に電気的に繋がる陰極リード端子4と、前記コンデンサ素子の全体を密封する合成樹脂製のパッケージ体5とを備え、前記リード端子を、前記パッケージ体の底部5aに、当該リード端子の下面が、前記パッケージ体の底面に露出するように埋設して成る固体電解コンデンサにおいて、前記陽極リード端子及び前記陰極リード端子のうち前記パッケージ体における側面5b, 5cに該当する部分に、立ち起こし片8, 9を設けて、この立ち起こし片を、前記パッケージ体内に、当該立ち起こし片の外表面がパッケージ体の側面に露出するように埋設することにより、半田付け強度を向上し、目視による半田付け良否の判別を容易にする。

WO 2005/055258 A1



NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。